

2022年3月期

第3四半期決算説明

2022年2月3日

芝浦メカトロニクス株式会社

3Q累計業績サマリー

* 3Q累計：4月～12月

■ 売上高・営業利益

- 売上高は計画どおりに推移し3Q累計で337億円、SPE分野比率が38%(2020/3Q累計) から56%(2021/3Q累計)に
- 営業利益はSPE分野の売上増加などにより、29.7億円(ROS 8.8%)

■ 受注高

- SPE分野での顧客の旺盛な投資から、3Q(10-12月)受注が想定を上回る242億円と高水準、3Q累計で536億円
- SPE分野比率が54%(2020/3Q累計) から61%(2021/3Q累計)に

3Q累計業績結果 (対前年)

【連結】

単位：億円

	2020						2021			3Q 累計	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	3Q 累計	4Q	年度	1Q	2Q	3Q		
売上高	99	135	86	320	128	448	101	118	118	337	+5%
営業利益	3.1	13.3	1.9	18.3	11.3	29.6	6.6	11.9	11.3	29.7	+62%
R O S	3.2%	9.9%	2.2%	5.7%	8.8%	6.6%	6.5%	10.1%	9.6%	8.8%	+3.1pt
経常利益	3.1	12.7	1.3	17.2	11.0	28.2	6.1	11.4	10.8	28.3	+65%
特別損失	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	6.1	-
当期純利益	0.7	10.7	0.2	11.7	8.0	19.7	▲1.9	9.4	7.7	15.2	+30%
受注高	88	94	125	307	113	420	149	145	242	536	+75%

3Q累計業績結果まとめ (対前年) ①

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

- 売上高 前年比5%増収 (320億円 ⇒ 337億円)
 - SPE分野は増加し、FPD分野が減少したが、全体として増収
- 営業利益 前年比62%増益 (18.3億円 ⇒ 29.7億円)
 - SPE分野の売上増加により、営業利益は増益
- 当期純利益 前年比30%増益 (11.7億円 ⇒ 15.2億円)
 - 1Qで横浜事業所再開発に伴う特別損失 (6.1億円) を計上したが、当期純利益は増益
- 受注高 前年比75%増加 (307億円 ⇒ 536億円)
 - SPE分野が好調に推移し、FPD分野も堅調に推移して、大幅増

3Q累計業績結果まとめ（対前年）②

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比1%減 (215億円 ⇒ 212億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやパワーデバイス向け、ウェーハ向けが堅調で増加。

FPD前工程では、前年度受注低調の影響などにより減少。

➤ セグメント利益 前年比7%増 (14.9億円 ⇒ 15.9億円)

半導体前工程は売上増加で増益で、FPD前工程が売上減少などで減益だが、全体として増益。

➤ 受注高 前年比60%増 (217億円 ⇒ 347億円)

半導体前工程では、ウェーハ向けやパワーデバイス向けを中心に好調に推移し、顧客の旺盛な投資による受注を獲得。

FPD前工程では、大型パネル向け、中小型パネル向けとも回復傾向にあるものの低水準で推移。

3Q累計業績結果まとめ（対前年）③

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

➤ 売上高 前年比22%増（78億円 ⇒ 96億円）

半導体後工程では、2.5Dなど先端パッケージ向けやFO-PLP向け、ディスプレイドライバIC向けが全体として好調で増加。

FPD後工程では、大型パネル向け装置は堅調であったものの、一部顧客の投資計画後ろ倒しの影響により減少。

➤ セグメント利益 前年比350%増（3.0億円 ⇒ 13.6億円）

半導体後工程の売上増加などにより増益。

➤ 受注高 前年比141%増（64億円 ⇒ 155億円）

半導体後工程では、先端パッケージ向けやFO-PLP向けを中心に好調に推移。

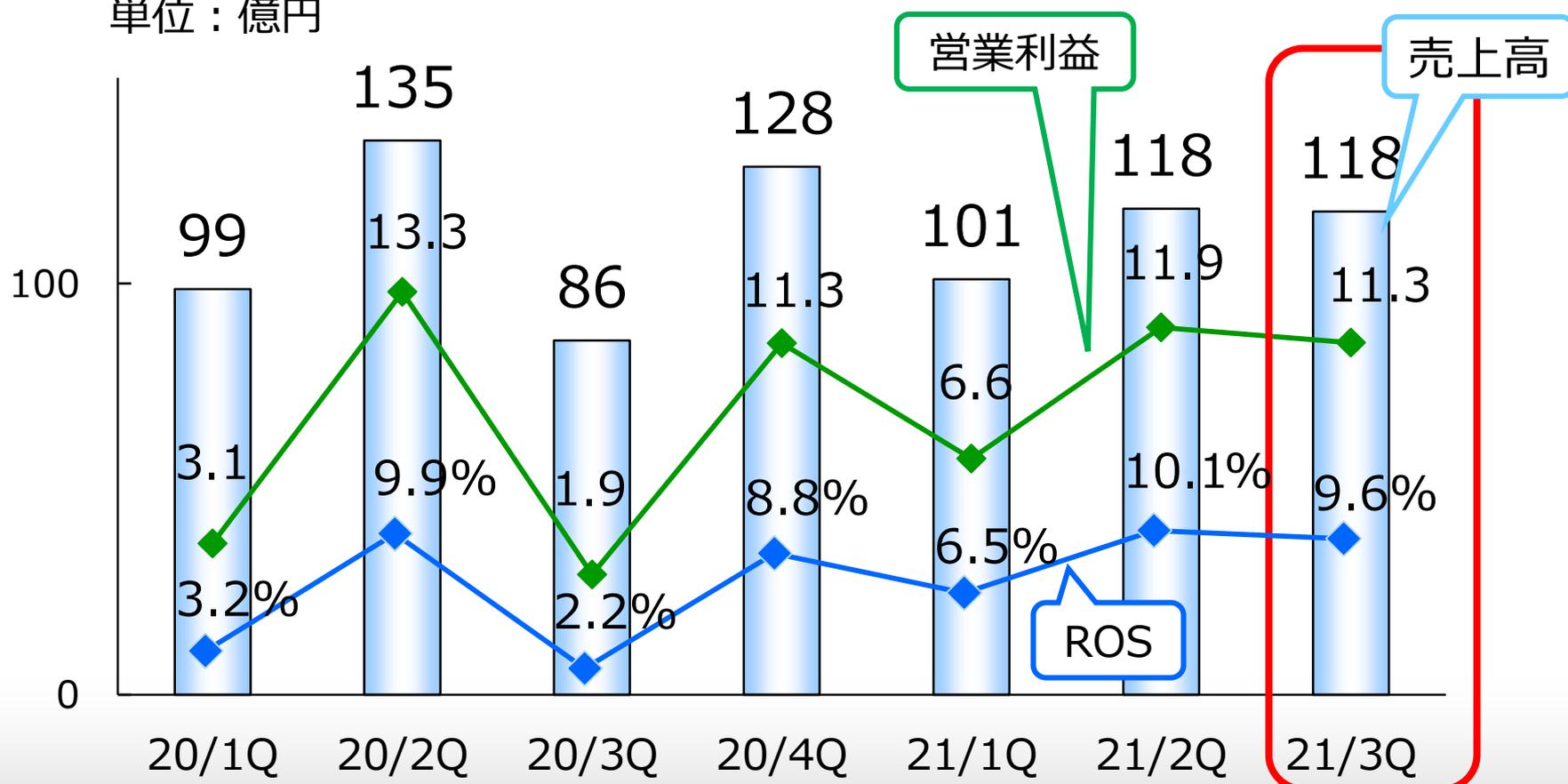
FPD後工程では、大型パネル向けが順調に推移し、中型パネル向けでは車載用新規装置の受注も獲得。

売上高・利益・ROS

ROS約10%で推移

【連結】

単位：億円



セグメント別売上高

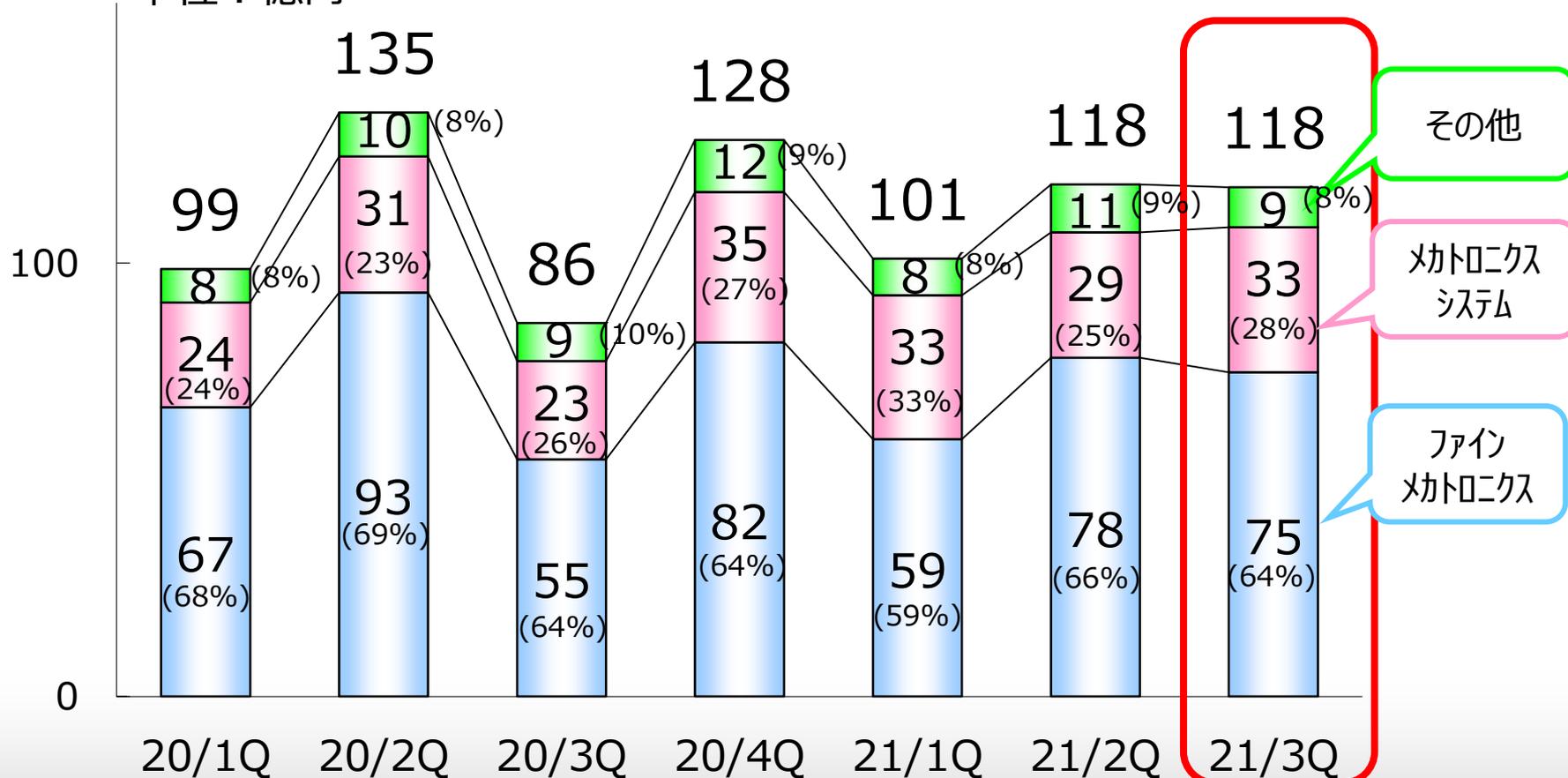
ファインメカトロニクスが60%台で推移

【連結】

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

単位：億円



分野別売上高

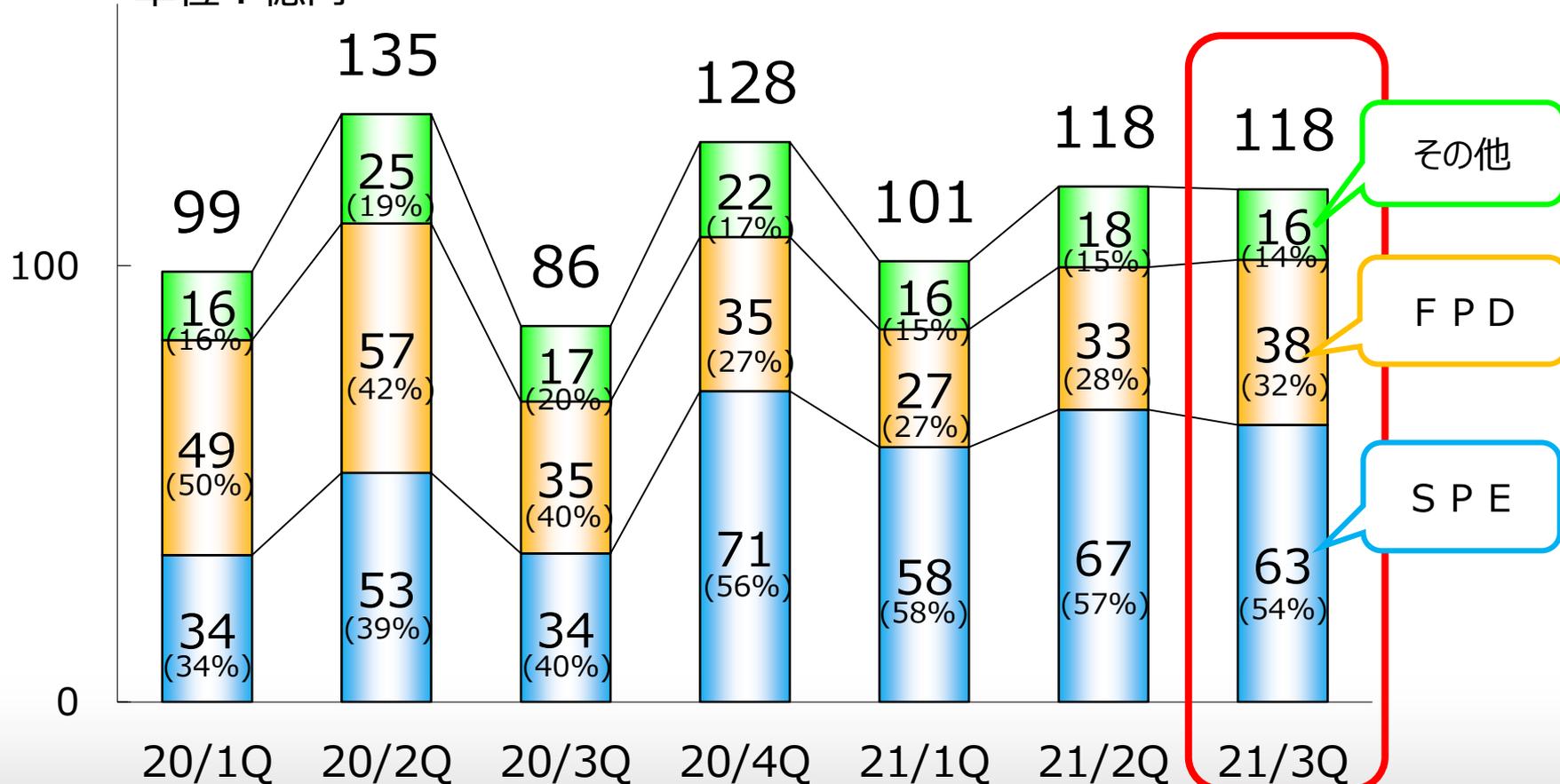
SPE分野が50%台で推移

【連結】

単位：億円

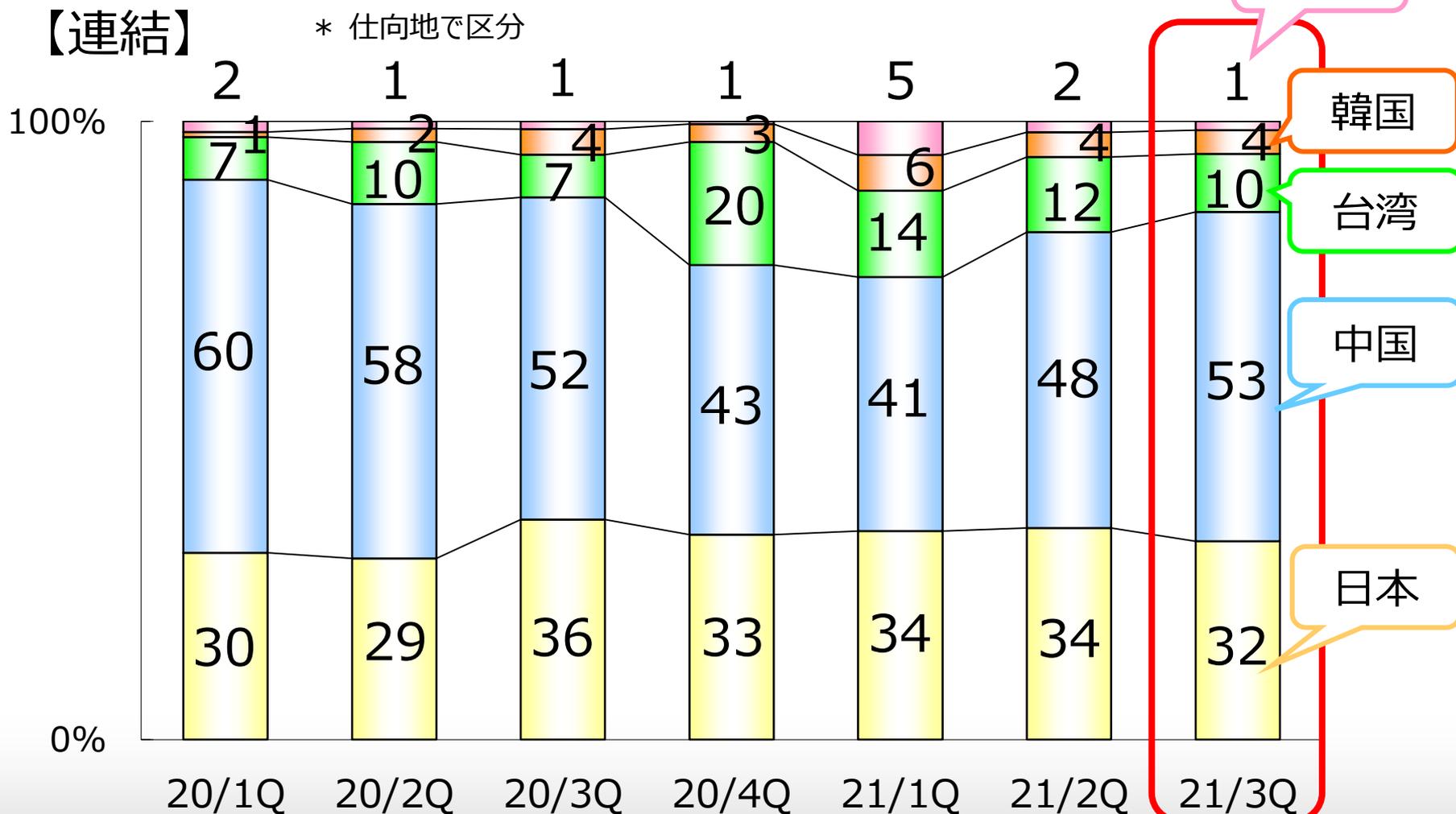
* FPD：FPD前・後工程装置

SPE：半導体前・後工程装置



地域別売上高比率

海外向け68% (中国53%)



セグメント別受注高

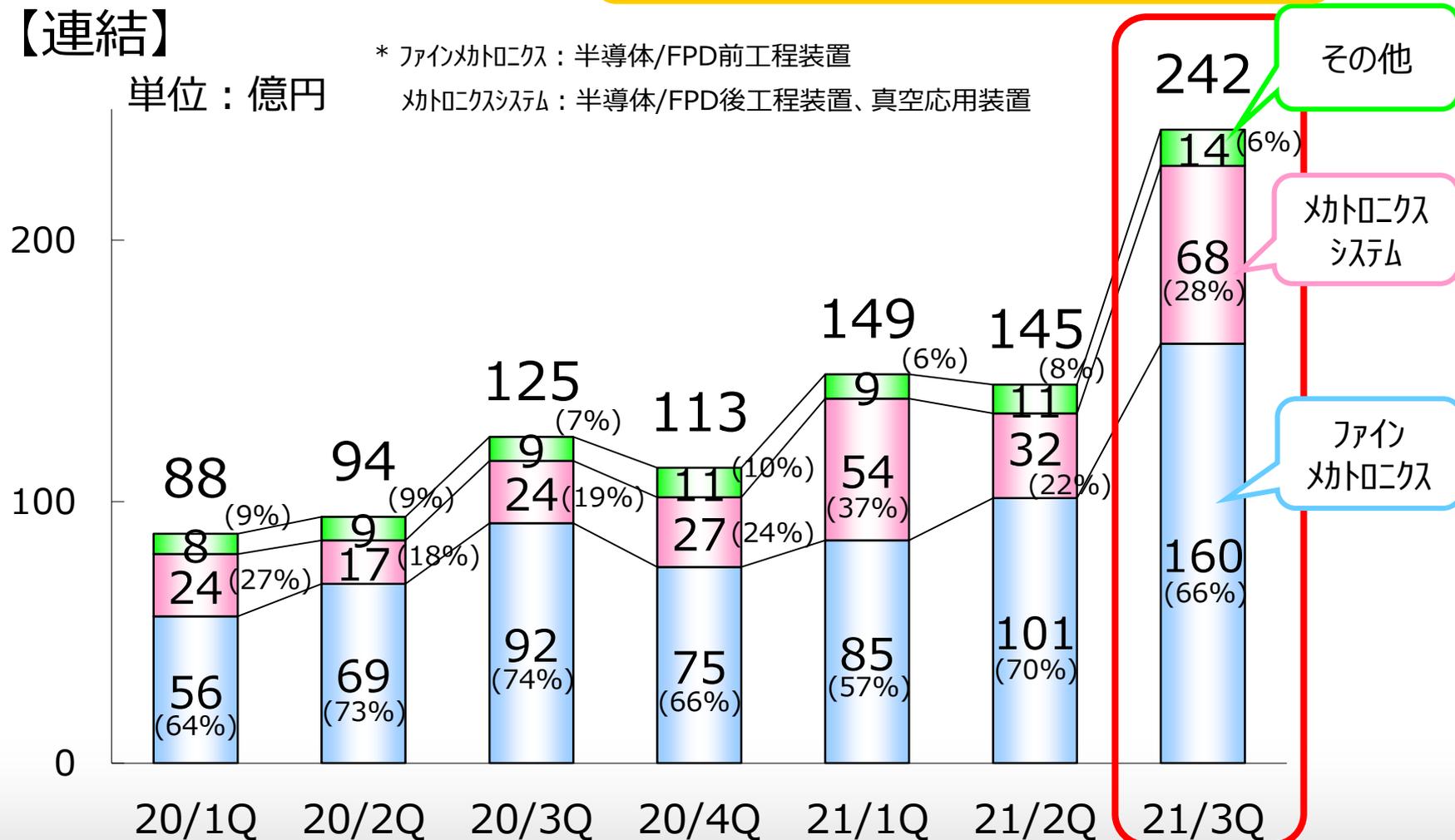
ファインメカトロニクス、メカトロニクスシステム
ともに大幅増で、高水準な受注

【連結】

単位：億円

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



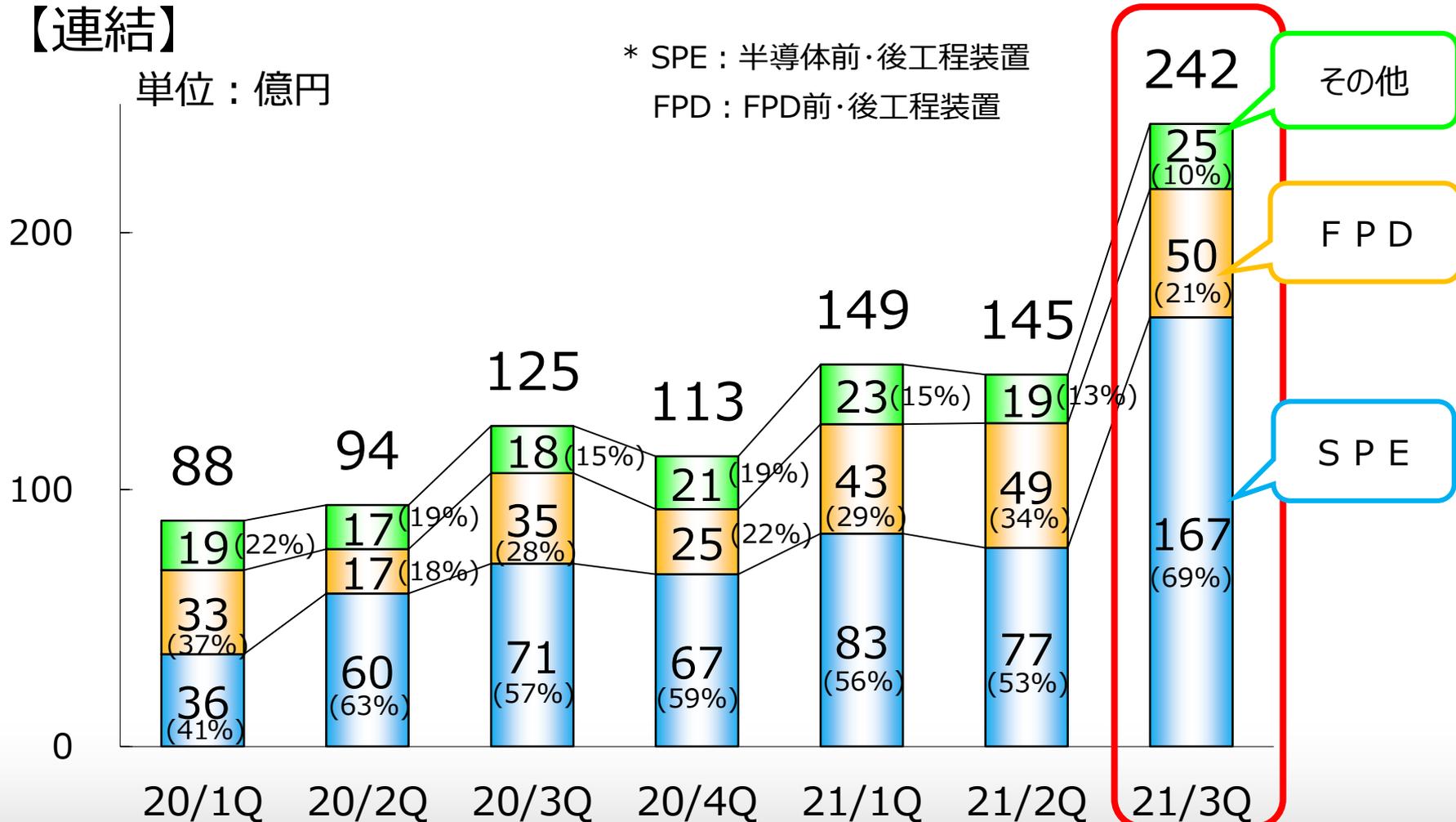
分野別受注高

SPE分野が大幅に増加し69%

【連結】

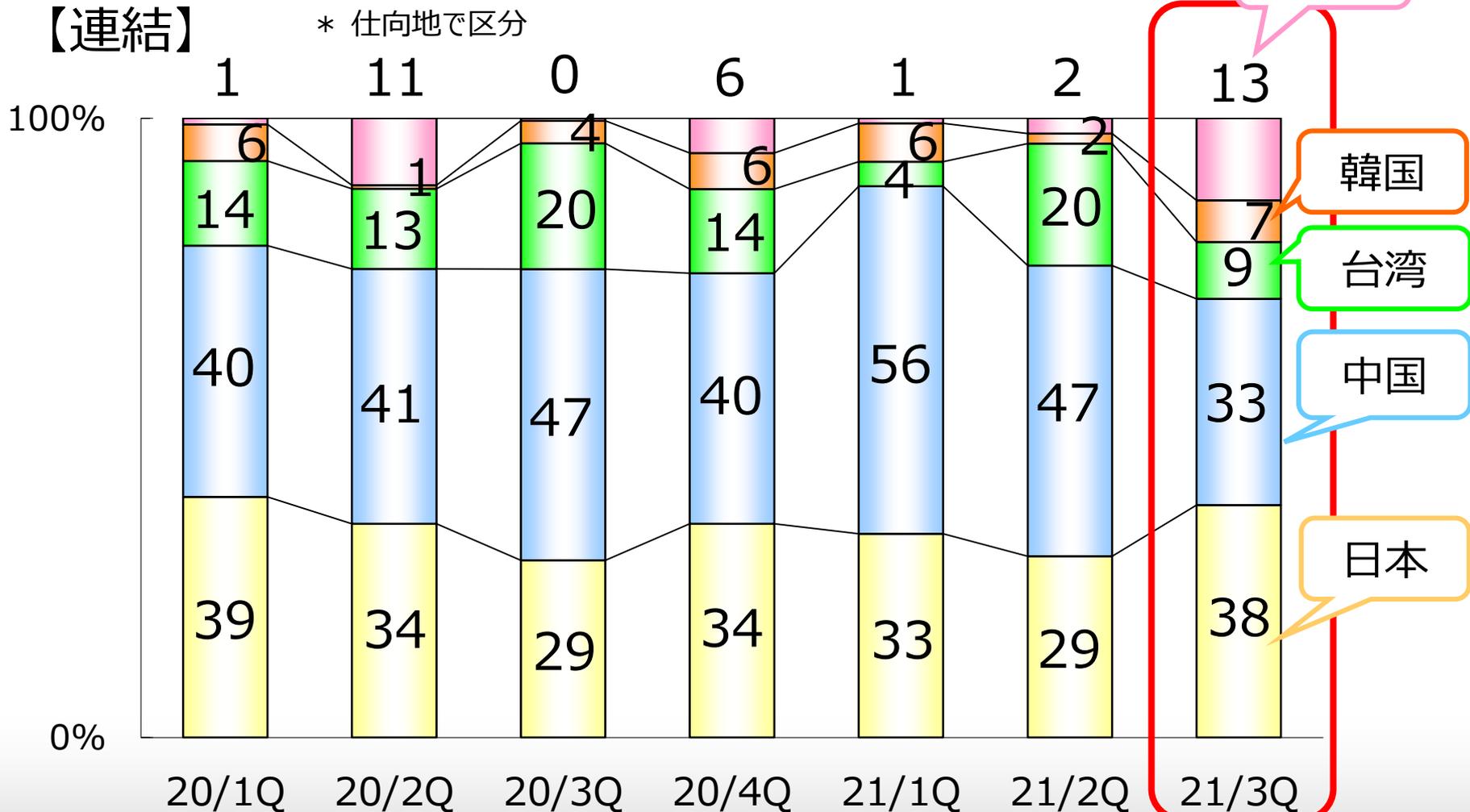
単位：億円

* SPE：半導体前・後工程装置
FPD：FPD前・後工程装置



地域別受注高比率

海外向け62% (中国33%)



貸借対照表

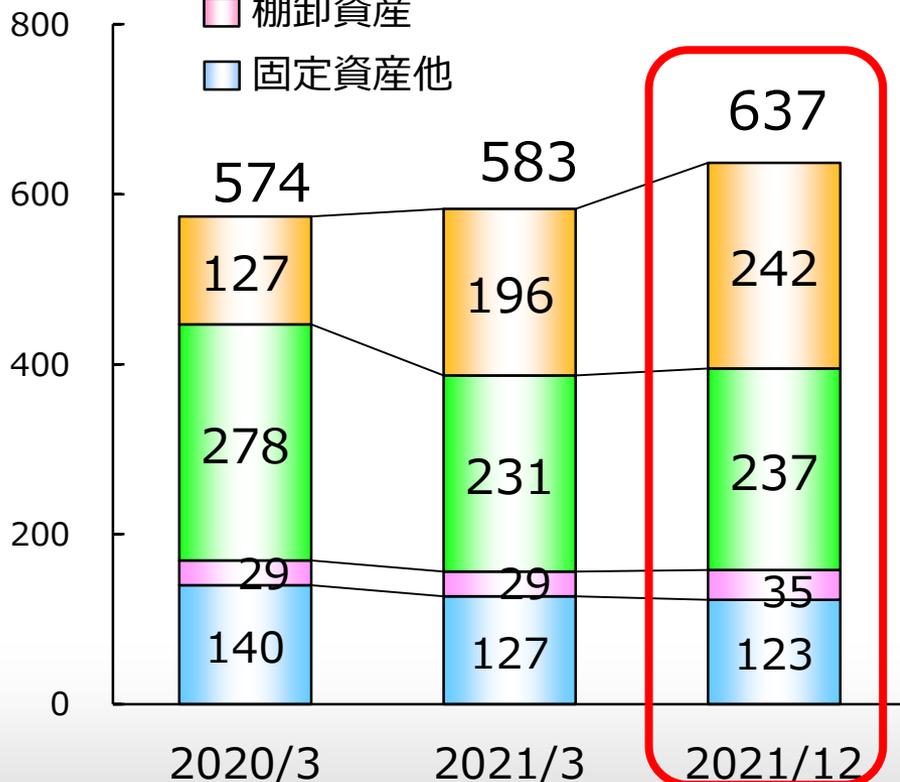
自己資本比率 '21/3 37% → '21/12 36%
D/Eレシオ '21/3 50% → '21/12 44%

【連結】

単位：億円

- 現金・預金
- 売上債権
- 棚卸資産
- 固定資産他

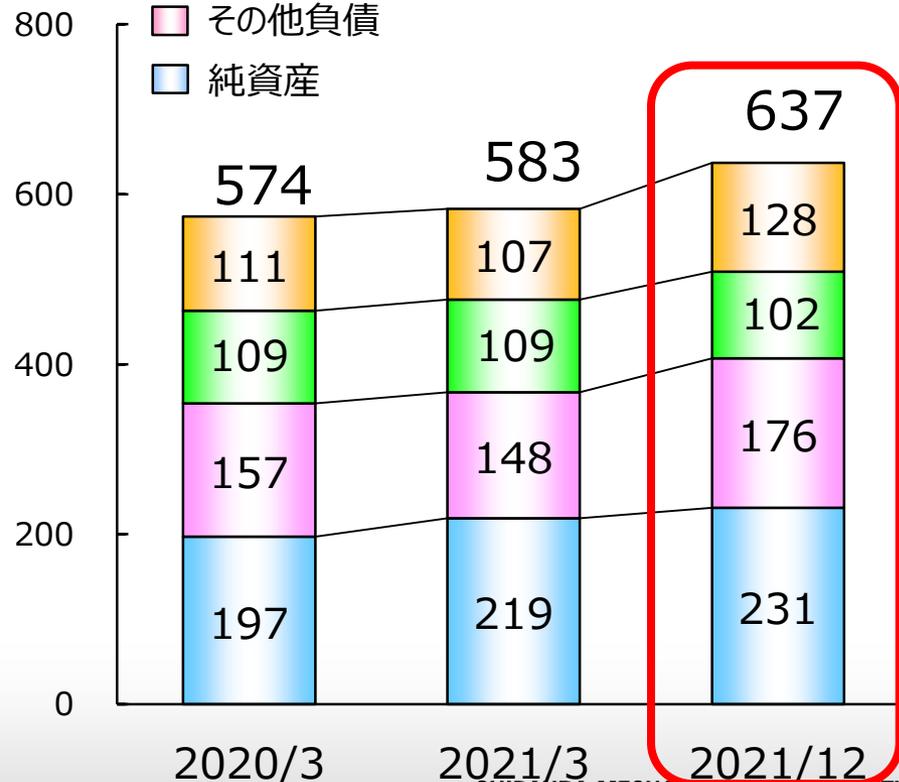
資産



単位：億円

- 買入債務
- 借入金 (長期・短期)
- その他負債
- 純資産

負債および純資産



業績予想

前回予想（11月）から変更なし

*1: 2021年5月公表

*2: 2021年11月公表

【連結】

単位：億円

	2020年度			2021年度		2021年度 予想
	20/3Q 累計	20/4Q	2020 年度	21/3Q 累計実績	21/4Q 予想	
売上高	320	128	448	337	143	480
営業利益	18.3	11.3	29.6	29.7	12.8	42.5
R O S	5.7%	8.8%	6.6%	8.8%	9.0%	8.9%
経常利益	17.2	11.0	28.2	28.3	12.2	40.5
特別損失	-	-	-	6.1	-	6.1
当期純利益	11.7	8.0	19.7	15.2	9.8	25.0
R O E	-	-	9.5%	-	-	11.0%
配当	-	-	110円	-	-	200円

前回予想 *2 2021 年度	期初予想 *1 2021 年度
480	480
42.5	40.0
8.9%	8.3%
40.5	38.0
6.1	6.1
25.0	21.0
11.0%	9.2%
200円	170円

SPE

- グローバルニッチトップ対象製品群の進捗良好
- Siウェーハ製造向け枚葉式洗浄装置や、パワーデバイス向けドライエッチング装置など、旺盛な投資により、想定を上回る受注獲得
- モジュールプロセスでも、先端パッケージ向け、FO-PLP向けボンダも同様に旺盛な投資により、継続的に受注獲得

* 当中期経営計画グローバルニッチトップ対象製品群

工程	対象装置
Siウェーハ製造	枚葉式洗浄装置
フォトマスク製造	・エッチング装置 ・枚葉式洗浄装置
ウェーハプロセス	枚葉式リン酸エッチング装置
モジュールプロセス	高精度フリップチップボンダ

FPD

- 前工程では、フレキシブルOLEDの投資時期が流動的だが、次期投資での採用に向けて、引続き真空焼成炉の顧客評価に注力
- 後工程では、車載用新規装置（中型OLB）の受注獲得、さらなるシェア拡大へμLEDディスプレイ向けも、市場発展に寄与すべく各社と連携した取組み継続
- ヘルスケア分野のインクジェット錠剤印刷装置も受注獲得

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END